

即时发布

投资者关系

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系

Becky Howland, 博士

企业通讯高级总监

(408) 875-9350

becky.howland@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣布推出 Kronos™ 1080 和 ICOS™ F160 检测系统： 拓展 IC 封装产品系列

加利福尼亚州米尔皮塔斯，2018年8月30日 - [KLA-Tencor 公司](#)（纳斯达克股票代码：KLAC）今日宣布推出两款全新缺陷检测产品，旨在解决各类集成电路（IC）所面临的封装挑战。**Kronos™ 1080** 系统为先进封装提供适合量产的、高灵敏度的晶圆检测，为工艺控制和材料处置提供关键的信息。**ICOS™ F160** 系统在晶圆切割后对封装进行检查，根据关键缺陷的类型进行准确快速的芯片分类，其中包括对侧壁裂缝这一新缺陷类型（影响高端封装良率）的检测。这两款全新检测系统加入 KLA-Tencor 缺陷检测、量测和数据分析系统的产品系列，将进一步协助提高封装良率以及芯片分类精度。

“随着芯片缩小的速度逐渐放缓，芯片封装技术的进步已成为推动元件性能的重要因素，” KLA-Tencor 高级副总裁兼首席营销官 Oreste Donzella 表示，“针对不同的元件应用，封装芯片需要同时满足各种元件性能、功耗、外形尺寸和成本的目标。因此，封装设计更加复杂多样，具有不同的 2D 和 3D 结构，并且每一代都更加密集而且尺寸更小。与此同时，封装芯片的价值在大幅增长，电子制造商对于产品质量和可靠性的期望也在不断地提升。为了满足这些期望，无论是芯片制造厂的后道工序还是在外包装配测试（OSAT）的工厂，封装厂商都需要灵敏度和成本效益更高的检测、量测和数据分析，同时需要更准确地识别残次品。我们的工程团队因而开发出全新 Kronos 1080 和 ICOS F160 系统，可以针对各种封装类型，满足电子行业对于适合量产的缺陷检测不断增长的需求。”

Kronos 1080 系统旨在检测先进晶圆级封装工艺步骤，为在线工艺控制提供各种缺陷类型的信息。先进封装技术必然包含更小的特征、更高密度的金属图案和多层再分布层 - 所有这些都对检测不断地提出更高要求，并要求创新的解决方案。Kronos 系统采用多模光学系统和传感器以及先进的缺陷检测算法，从而实现了领先业界的性能。Kronos 系统还引入了 FlexPoint™，一项源自 KLA-Tencor 领先的 IC 芯片制造检测解决方案的先进技术。FlexPoint 将检测集中在芯片的关键区域，因为这些区域内的缺陷会产生最大的影响。灵活的晶圆处理能够检测高度扭曲晶圆，这经常会出现这扇出型晶圆级封装中 - 该封装工艺对移动应用已是常规技术，并且是网络和高性能计算应用中的新兴技术。

晶圆级封装通过测试和切割之后，**ICOS F160** 执行检测和芯片分类。高端封装（如移动应用）的制造商，将受益于该系统的新功能 -- 检测激光沟槽、发丝裂缝和侧壁裂缝。这是由密集金属布线上的所采用的新绝缘材料引起的，改变绝缘材料是为了提高速度并降低功耗。新材料易碎，使其在晶圆切割过程中容易出现裂缝。众所周知，侧壁裂缝非常难以检测，因为它们垂直于芯片表面，因而无法用传统的目测检测发现。**ICOS F160** 系统的灵活性也是其另外一优势，使其有利于许多封装类型：输入和输出模式可以是晶圆、托盘或磁带。系统可以轻松地从一种设置改换到另一种设置。其自动校准和精密芯片攫取也有助于提高批量制造环境中的设备利用率。

Kronos 1080 和 **ICOS F160** 系统是 KLA-Tencor 封装解决方案系列产品的一部分，旨在满足各种 IC 封装类型的检测、量测、数据分析和芯片分类的需求。该系列产品包括 [CIRCL™-AP](#) 全表面晶圆检测系统，用于晶圆和面板的 [Zeta-580/680](#) 3D 量测系统，**ICOS™ T890**，**T3** 和 **T7 系列** 元件检测和量测系统，以及 [Klarity®](#) 数据分析系统。有关这两种新型缺陷检测系统和 KLA-Tencor 完整的封装解决方案系列产品的更多信息，请参见[封装系列产品的网页](#)。

关于 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是全球领先的工艺控制及良率管理解决方案的设备供应商。该公司与全球的客户合作，开发最先进的检测和量测技术，致力服务于半导体及其他相关纳米电子工业。凭借业界标准产品组合和世界一流的工程师科学家团队，公司 40 余年来持续为客户打造卓越的解决方案。KLA-Tencor 公司的总部位于加利福尼亚州米尔皮塔斯市（Milpitas），并在全球设有专属的客户运营和服务中心。更多相关信息，请访问公司网站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

Forward Looking Statements:

前瞻性声明:

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 Kronos 1080 和 ICOS F160 系统的预期性能以及缺陷减少和芯片精确分类为封装制造设施所带来的经济影响都是前瞻性陈述，并且符合《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）中“安全港” (Safe Harbor) 条款的规定。这些前瞻性声明基于目前的信息及预期，并且受到诸多风险与不确定性影响。由于各种实际因素，例如（由于成本、性能抑或其他原因造成的）新技术推迟、其他公司推出竞争性产品、或影响 KLA-Tencor 产品的实施、性能或使用的意外技术挑战或限制等影响，实际结果可能与此类声明中的预计结果大不相同。

###